

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

## 中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号 2019-025

投资者来访类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观																																
来访单位名称及人员姓名	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="351 857 694 936">来访人员姓名</th><th data-bbox="694 857 1412 936">公司</th></tr></thead><tbody><tr><td>郑冰仪</td><td>汇丰前海</td></tr><tr><td>陈俊哲</td><td>兴业自营</td></tr><tr><td>郜震霄</td><td>兴业自营</td></tr><tr><td>刘奕司</td><td>东兴证券</td></tr><tr><td>郭旺</td><td>长城证券</td></tr><tr><td>蔡锐帆</td><td>广发电子</td></tr><tr><td>马磊</td><td>汇添富基金</td></tr><tr><td>汪磊</td><td>华泰证券</td></tr><tr><td>姜月</td><td>毅木资产</td></tr><tr><td>祝俭</td><td>毅木资产</td></tr><tr><td>刘航</td><td>国海证券</td></tr><tr><td>季天华</td><td>国泰安保基金</td></tr><tr><td>张标</td><td>国泰安保基金</td></tr><tr><td>张青华</td><td>国泰安保基金</td></tr><tr><td>欧阳奇正</td><td>金恒宇资管</td></tr></tbody></table>	来访人员姓名	公司	郑冰仪	汇丰前海	陈俊哲	兴业自营	郜震霄	兴业自营	刘奕司	东兴证券	郭旺	长城证券	蔡锐帆	广发电子	马磊	汇添富基金	汪磊	华泰证券	姜月	毅木资产	祝俭	毅木资产	刘航	国海证券	季天华	国泰安保基金	张标	国泰安保基金	张青华	国泰安保基金	欧阳奇正	金恒宇资管
来访人员姓名	公司																																
郑冰仪	汇丰前海																																
陈俊哲	兴业自营																																
郜震霄	兴业自营																																
刘奕司	东兴证券																																
郭旺	长城证券																																
蔡锐帆	广发电子																																
马磊	汇添富基金																																
汪磊	华泰证券																																
姜月	毅木资产																																
祝俭	毅木资产																																
刘航	国海证券																																
季天华	国泰安保基金																																
张标	国泰安保基金																																
张青华	国泰安保基金																																
欧阳奇正	金恒宇资管																																

	王希龙	金恒宇资管
	万定山	观富资产
	谭聪	弘尚资产
	钱墮	嘉合基金
	向柯舟	成都万象华城投资
	傅奕翔	华泰保兴基金
	陈晓菊	华泰保兴基金
	欧阳志宏	弘则研究
时间	2019年10月23日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员	潘一德	
投资者来访主要内容介绍	<p>首先由董事会秘书潘一德先生向电子行业分析师摘要介绍公司的情况、产品市场和公司未来发展的展望。然后现场回答了提问，具体内容如下：</p> <p><b>1、来宾问：公司锂电池管理芯片情况？</b></p> <p>潘一德：锂电池应用越来越广泛，市场处于增长期，公司推出多款锂电池管理芯片新产品以丰富产品线。主要应用于手机、笔记本电脑、电动工具及电动自行车及其他等，也包含使用锂电池的通讯基站。产品的应用场景持续增加，公司也持续丰富产品线。随着手机快充需求加大，越来越多的高端手机需要采用锂电池计量芯片，锂电池管理芯片在知名品牌客户端已经开始实现小量销售。公司对于全年锂电池管理芯片的销售持续实现增长很有信心。</p> <p>由于研发团队在锂电池管理芯片技术的不断扎根，产品质量也随之提升，公司的锂电池管理芯片产品已经在业界建立良好的声誉，并得到了越来越多的大型品牌客户认可和导入，正在打开国产替代的道路上进一步开拓。</p> <p><b>2、来宾问：公司第三季产品的毛利率情况？</b></p> <p>潘一德：公司第三季受产品组合不同导致的毛利率降低，个别产品的毛利率没有波动。</p> <p><b>3、来宾问：公司研发费用为何增长？</b></p>	

潘一德：公司研发费大部分是研发人员的薪资，公司会根据发展需要有序加大投入研发，主要是为了创造长期可持续的增长，其中近 1/3 的研发费用于 AMOLED 显示驱动芯片，公司新增长部分的研发费用主要用于汽车电子芯片研发，研发费投入仍呈现增长趋势。

#### **4、 来宾问：介绍一下公司的人员情况？**

潘一德：公司现有员工 300-400 人，一直有在努力招聘，不管是校园招聘还是社会招聘，以期增加员工。公司采用复合式的多项激励留才措施和利润中心的考核方式，人员比较稳定，公司有 3/4 以上的员工有 5 年年资以上。

公司是以人才为主的知识密集型公司，公司的核心竞争力是研发人才，公司目前的研发人员是靠自身培养和招聘有经验的人员。

#### **5、 来宾问：介绍一下公司工控类产品的情况？**

潘一德：公司在家电主控芯片领域属于国际领先，其中白电主控芯片已与欧美日国际品牌大厂进行市场化竞争；小家电主控芯片的主要竞争对手主要来自于是韩国、台湾的上市公司。

公司持续在白色家电主控、电机控制及智能电表领域扩大市场份额。今年前三季度，公司在家电应用市场的产品导入项目数量增加、变频空调主控芯片也有客户新增设计导入，国内部分客户对公司工控单芯片的接受度不断提高，更多的品牌客户与公司积极开展了广泛的合作，公司在家电主控芯片领域已经大量实现进口替代，公司将持续在自身专注的市场领域稳步提高芯片国产化率。

工控单芯片产品开发、导入及客户验证的时间长，主要是靠技术积累，在技术创新、市场地位、产品质量及性价比等方面赢得了市场综合竞争优势。

#### **6、 来宾问：公司小家电市场份额增加的原因？**

潘一德：公司非常注重产品品质和可靠性，对国内客户有就近服务的优势，及时提供大客户工程支持服务，与客户建立了彼此的信任感。从而赢得了市场综合竞争的优势。

#### **7、 来宾问：AMOLED 产品线的研发情况？**

潘一德：公司早期就已投入研发显示屏驱动芯片，有了一定的技术积累。子公司推出的 FHD AMOLED 显示驱动芯片自去年三季度末进入量产，迄今累计实现销售已经超过千万元，今年 4 季度计划推出 AMOLED 显示驱动芯片的新产品。公司产品的

	<p>品质、功耗和可靠度都能满足面板厂的需求，产品目标市场主要针对国内厂商。</p> <p>PMOLED 屏的部份应用市场被 AMOLED 屏替代了，导致 PMOLED 显示驱动芯片的销售出现下滑。公司对于国内的 AMOLED 产业发展，持续保持乐观看法，市场将进一步扩大。</p> <p>公司目前实现销售的 FHD AMOLED 显示驱动芯片限于硬屏。</p> <p><b>8、 来宾问：公司芯片的晶圆代工情况？</b></p> <p>潘一德：公司与晶圆厂有多年合作，主要看芯片应用的需求而定，往来的主要有和舰、华虹宏力等，目前产能可满足公司需求，公司对于未来产能的更多需求也有规划。公司产品主要是工控类，研发时间长，主要是靠技术积累，市场本身是动态竞争的。</p> <p><b>9、 来宾问：介绍一下公司库存情况？</b></p> <p>潘一德：公司产品一般是以销售预测定产，订单能见度大概为 1 个月，也会备货一些有稳定销售的产品，一般维持 4 个月的库存，经销商一般会有半个月的备货以满足市场的需要。</p> <p><b>10、 来宾问：公司是否考虑利用外延式增长来发展？</b></p> <p>潘一德：对外投资是公司经营的策略方向，公司一直有在评估。公司会积极考虑类似与从事无线通讯、电机控制和电源有关的芯片设计公司合作，或策略伙伴的外延式增长方式将公司做强做大，主要关注重要的核心技术与公司技术的相关性及互补性，及被购并公司研发团队将来的稳定性。主要也要有协同效应及发展前景。</p>
附件清单	
日期	2019 年 10 月 23 日